

Häusermann auf den Messen SMT/Hybrid/Packaging 2012 und PCIM Europe 2012

24.04.2012, 17:46 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *Häusermann*

Presseagentur: *Redaktionsbüro Consee*



HSMtec verwendet Profile und Drähte aus Kupfer um hohe Ströme zu stemmen und Hitze abzuleiten

Häusermann: Doppelter Messeauftritt mit innovativer Leiterplattentechnik für Hochstrom-Anwendungen und Power-LEDs

SMT/Hybrid/Packaging 2012 in Halle 9, Stand 210

PCIM Europe 2012 in Halle 12, Stand 470

Gars am Kamp, den 24.04.2012 – Häusermann, österreichischer Leiterplattenhersteller, wird sowohl auf der SMT/Hybrid/Packaging 2012 (Halle 9, Stand 210) als auch auf der PCIM Europe 2012 (Halle 12, Stand 470) ausstellen. Beide Messen finden zeitgleich vom 08. bis 10. Mai 2012 in Nürnberg statt. Im Fokus steht jeweils die mehrfach patentierte und von unabhängigen Prüfinstituten qualifizierte Platinentechnik HSMtec, die für den Einsatz in Hochstrom-Anwendungen und für Power-LEDs ausgelegt ist. Auf den beiden Messeständen werden entsprechende Demonstratoren ausgestellt sein, die anschaulich die Funktionsweise von HSMtec zeigen.

Die in konventionellem Fertigungsverfahren hergestellten HSMtec-Leiterplatten ermöglichen ein effizientes Wärmemanagement mittels massiven Kupferelementen. Nur dort, wo tatsächlich hohe Ströme durch die Leiterplatte fließen sollen, werden die je nach Anwendung notwendigen Kupferprofile und/oder Kupferdrähte in die Leiterplatte integriert. Die Kupferprofile sind grundsätzlich 500 µm hoch und in Breiten von 2,0 mm bis 12 mm in variabler Länge erhältlich. Hingegen hat sich bei den Drähten der Durchmesser von 500 µm etabliert. Die mit den Leiterbildern stoffschlüssig verbundenen 500 µm dicken Strukturen lassen sich mittels Ultraschallverbindungstechnik direkt auf das Basiskupfer auftragen und mit FR4-Basismaterial in jede beliebige Lage eines Multilayers integrieren. HSMtec ist nach DIN EN 60068-2-14 und JEDEC A 101-A qualifiziert und auditiert für Luftfahrt und Automotive.

Leuchtend auf der SMT/Hybrid/Packaging 2012

Während der auf die elektronische Baugruppenfertigung ausgerichteten Messe SMT/Hybrid/Packaging 2012 wird Häusermann in Halle 9, Stand 210 das Referenzdesign LEDagon präsentieren. Das im Verbund mit Arrow Electronics, Cree und Kathrein-Austria realisierte Projekt basiert auf der HSMtec-Platinentechnik von Häusermann. Dabei gilt es, die Wärmeentwicklung der on-Top angebrachten High-Power-LED XM-L von Cree mit bis zu 10 W und der sechs Medium-Power-LED XT-E desselben Herstellers mit bis zu 3 W rasch abzuleiten. Da HSMtec selbsttragende mehrdimensionale Konstruktionen ermöglicht, lassen sich die einzelnen Leiterplattensegmente individuell in die gewünschte Einbaulage und Ausrichtung bringen. Die individuellen, zu einem Oktagon geformten Leiterplattensegmente sorgen für photometrische Flexibilität und interessante optische Lösungen.

Mit Power auf der PCIM Europe 2012

Auf dem ECPE-Gemeinschaftsstand (European Center for Power Electronics e.V.) in Halle 12, Stand 470 wird Häusermann während der parallel im Westteil der NürnbergMesse stattfindenden Messe für Leistungselektronik, PCIM Europe 2012, die Leiterplattentechnik mit einer Hochstrom-Anwendung vorstellen. Um für Leistungsmodule eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicherzustellen, ist beginnend von dem aufgelöteten Bauteil bis zum Kühlkörper eine optimale Wärmeabfuhr zu gewährleisten. HSMtec erlaubt das partielle Führen von hohen Strömen (typisch bis 500 A) in Kombination mit Steuerelektronik auf einer Leiterplatte. Bestens geeignet ist HSMtec für den Einsatz in der Motorsteuerung eines Gleichstrommotors mit IGBT, oder für den rasant wachsenden Markt der Elektromobilität: Die Kombination von Ansteuerungs- und Signalverarbeitungstechnik mit Leistungshalbleitern auf einer Leiterplatte stellt insbesondere in der Elektromobilität eine Herausforderung dar. Neben den Anforderungen an Platz und Gewicht gilt es, hohe Ströme zu bewältigen und gleichzeitig für rasche Abwärme zu sorgen.

„Anhand einer großen Zahl von empirischen Untersuchungen konnten wir Platinenhersteller unser Know-how in den Bereichen des thermischen Managements und Hochstrom auf der Leiterplatte deutlich erweitern“, erklärt Stefan Hörth, Product Manager HSMtec von Häusermann und fügt hinzu: „Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen ermöglichen es uns, unsere Kunden unkompliziert und aktiv bei der thermischen Dimensionierung und dem Design von Leiterplatte und Baugruppe zu unterstützen.“

Portrait

Über Häusermann

Häusermann hat sich mit der Herstellung von Leiterplatten und Folientastaturen von einem Pionier in der Leiterplattenproduktion zu einem führenden High-Tech-Unternehmen entwickelt. Die Erfolgsgrundlage des Unternehmens beruht auf Zuverlässigkeit, Liefertreue und Technologie-Kompetenz. Flexibles Eingehen auf Anforderungen und individuelle technische Beratung machen Häusermann zum starken Partner für Unternehmen aus der Industrieelektronik, der Steuerungs-, Mess- und Regeltechnik, EMS (Electronic Manufacturer Services) sowie Medizintechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Das Leiterplatten-Portfolio reicht von HDI/Microvia und Multilayer über starrflexible und doppelseitige Platinen. Herausragend ist die HSMtec-Technologie, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, die hohe Ströme verwenden und effizientes Wärmemanagement benötigen.

News-ID: 627157 • Views: 1030 (Stand: 12.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/627157/Haeusermann-auf-den-Messen-SMT-Hybrid-Packaging-2012-und-PCIM-Europe-2012.html>